

FALIT FS Laser Decapsulation System



功能/应用

激光开封是一种可以在不损害芯片整体功能的情况下局部去除模塑材料的技术。与化学开封技术相比，激光开封更有效，并减少暴露于强酸蚀刻的环境。

规格

横截面激光切割模块:

型号: Draco-51S40A 绿色激光

波长: 532 纳米

平均输出功率: >10 瓦 在 40 千赫兹

脉冲宽度: <30 纳秒 在 30 千赫兹

激光开封模块:

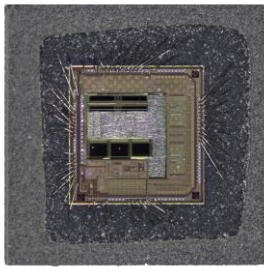
型号: Harrier-1064-14-L-V3 红外线激光

波长: 1064 纳米

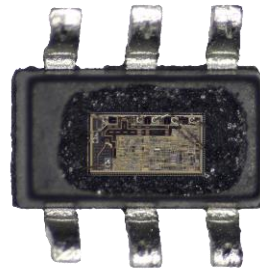
平均输出功率: >12 瓦 在 10 千赫兹

脉冲宽度: <40 纳秒 在 10 千赫兹

示例应用图片



5x5 QFN 开封



SOT23-6 开封

设备制造商网页

<https://www.controllaser.com/products/falit-failure-analysis-laser-inspection-tools-for-laser-decap-cross-sectioning-delidding/#one>

Youtube 演示视频

https://www.youtube.com/watch?v=LIb__2FrT4s